

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2021-011

## 深南电路股份有限公司 2020 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

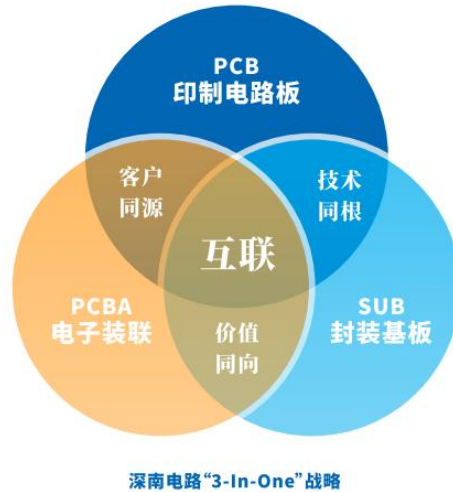
#### 1、公司简介

股票简称	深南电路	股票代码	002916
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张丽君	谢丹	
办公地址	深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼	深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼	
电话	0755-86095188	0755-86095188	
电子信箱	stock@scc.com.cn	stock@scc.com.cn	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

##### （一）主要业务、主要产品及其用途

深南电路始终专注于电子互联领域，致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”，拥有印制电路板、电子装联、封装基板三项业务，形成了业界独特的“3-In-One”业务布局：即以互联为核心，在不断强化印制电路板业务领先地位的同时，大力发展与其“技术同根”的封装基板业务及“客户同源”的电子装联业务。



### 1、印制电路板产品

公司专业从事中高端印制电路板的设计、研发及制造，产品应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并持续深耕工控、医疗等领域。公司当前重点开拓的领域包括：

(1) 通信领域。公司自上世纪90年代进入通信PCB领域，至今已有二十余年经验技术积累。公司生产的通信印制电路板主要应用于无线网、传输网、核心网、固网宽带等企业级应用场景。伴随国家5G通信网络建设及商用，公司积极配合客户开发通信设备端PCB产品，加快对高密度、高集成、高速高频、高散热、小型化PCB产品的开发。

(2) 数据中心领域（含服务器）。随着各行业数字化、物联网和人工智能等应用逐渐落地，服务器需求呈现高速增长趋势，公司将持续加强对相关产品的开发，为市场突破做好技术准备。

经过多年的积累，公司在背板、高速多层板、高频微波板等各种中高端PCB加工工艺方面拥有了领先的综合技术能力，树立了PCB技术的行业领先地位。同时，公司持续加强专业化、自动化工厂布局，并积极推进智能制造。

公司PCB产品重点应用领域

应用领域	主要设备	相关PCB产品	特征描述	
通信	无线网	通信基站	背板、高速多层板、高频微波板、多功能金属基板	金属基、大尺寸、高多层、高频材料及混压
	传输网	OTN传输设备、微波传输设备	背板、高速多层板、高频微波板	高速材料、大尺寸、高多层、高密度、多种背钻、刚挠结合、高频材料及混压
	核心网	路由器、交换机	背板、高速多层板、高频微波板	高速材料、大尺寸、高多层、高密度、多种背钻、刚挠结合、高频材料及混压
	固网宽带	OLT、ONU等光纤到户设备		多层板、刚挠结合
数据中心	交换机、服务器/存储设备	背板、高速多层板	高速材料、大尺寸、高多层、高密度、多种背钻、刚挠结合	
工控医疗	工控、医疗系统		高可靠性、多层板、刚挠结合	
消费电子	电池保护、光学摄像、无线耳机等	刚挠结合板、HDI	高密度、轻薄、立体组装、高可靠性	
汽车电子	毫米波雷达、激光雷达、摄像头、新能源汽车	高频微波板、刚挠结合板、厚铜板	高频材料及混压、高可靠性、HDI、刚挠结合、多层板、厚铜	

### 2、封装基板产品

封装基板是芯片封装不可或缺的一部分，不仅为芯片提供支撑、散热和保护作用，同时为芯片与PCB母板之间提供电气连接。公司生产的封装基板产品主要分为五类，分别为存储芯片封装基板、微机电系统封装基板、射频模块封装基板、处理器芯片封装基板和高速通信封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务/存储等。

公司目前已形成具有自主知识产权的封装基板生产技术和工艺，建立了适应集成电路领域的运营体系，并成为日月光、安靠科技、长电科技等全球领先封测厂商的长期合作伙伴，在部分细分市场上拥有领先的竞争优势。例如，公司制造的硅麦克风微机电系统封装基板大量应用于苹果和三星等智能手机中，全球市场占有率超过30%。射频模组封装基板大量应用于4G和5G手机射频模块封装；应用于嵌入式存储芯片的高端存储芯片封装基板已大规模量产；在处理器芯片封装基板方面，倒

装封装 (FC-CSP)基板已具备量产能力。

### 3、电子装联产品

电子装联指依据设计方案将无源器件、有源器件、接插件等电子元器件通过插装、表面贴装、微组装等方式装焊在PCB上,实现电子与电气的互联,并通过功能及可靠性测试,形成模块、整机或系统,属于PCB制造业务下游环节。公司电子装联产品按照产品形态可分为PCBA板级、功能性模块、整机产品/系统总装等,业务主要聚焦通信、医疗电子、汽车电子等领域,同时也加快布局工控、能源与设计等领域。目前公司已具备为客户提供包括产品设计、开发、生产、装配、系统技术支持等全方位服务的能力。

凭借专业的设计能力、扎实的技术实力、稳定可靠的质量口碑以及快速的客户响应,公司电子装联业务已与通用电气等全球领先企业建立起长期战略合作关系。公司坚持深耕大客户策略,电子装联业务多年来始终保持稳定发展。为持续提高效率,公司同步推进自动化建设等项目。

#### (二) 行业地位

深南电路成立于1984年,经过三十余年的深耕与发展,已成为中国印制电路板行业的领先企业,中国封装基板领域的先行者,电子装联制造的先进企业。公司系国家火炬计划重点高新技术企业、印制电路板行业首家国家技术创新示范企业及国家企业技术中心;同时,作为中国电子电路行业协会(CPCA)的理事长单位及标准委员会会长单位,公司主导、参与了多项行业标准的制定。

目前,公司已成为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商。根据Prismark行业报告,2020年公司在全球印制电路板厂商中位列第八名。

公司在全球PCB产业中的排名

年份	2009年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
排名	60	29	21	19	14	8	8

数据来源:历年Prismark报告

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	11,600,456,950.24	10,524,196,882.92	10.23%	7,602,141,701.41
归属于上市公司股东的净利润	1,430,111,325.18	1,232,775,470.34	16.01%	697,252,358.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,294,094,538.71	1,151,701,243.26	12.36%	647,335,618.09
经营活动产生的现金流量净额	1,799,999,047.12	1,262,866,434.48	42.53%	879,133,564.83
基本每股收益(元/股)	3.00	2.62	14.50%	1.48
稀释每股收益(元/股)	2.98	2.61	14.18%	1.48
加权平均净资产收益率	23.86%	29.11%	-5.25%	20.38%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	14,007,819,588.20	12,219,367,752.05	14.64%	8,525,409,856.54
归属于上市公司股东的净资产	7,441,079,748.97	5,000,803,881.38	48.80%	3,722,440,662.83

### (2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,497,505,738.18	3,417,896,429.82	3,067,104,206.84	2,617,950,575.40

归属于上市公司股东的净利润	276,780,417.67	447,537,774.10	373,775,193.96	332,017,939.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	254,392,953.13	410,460,510.08	338,568,420.00	290,672,655.50
经营活动产生的现金流量净额	363,828,127.37	440,012,213.92	540,320,227.38	455,838,478.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	100,868	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	96,960	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中航国际控股有限公司	国有法人	67.05%	328,068,670	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.50%	12,245,994	0			
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	3,213,463	0			
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.33%	1,592,262	0			
李雪红	境内自然人	0.30%	1,480,036	0			
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	1,100,913	0			
中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.20%	962,246	0			
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	0.15%	749,968	0			
统一证券投资信托股份有限公司—统一强	境外法人	0.15%	735,296	0			

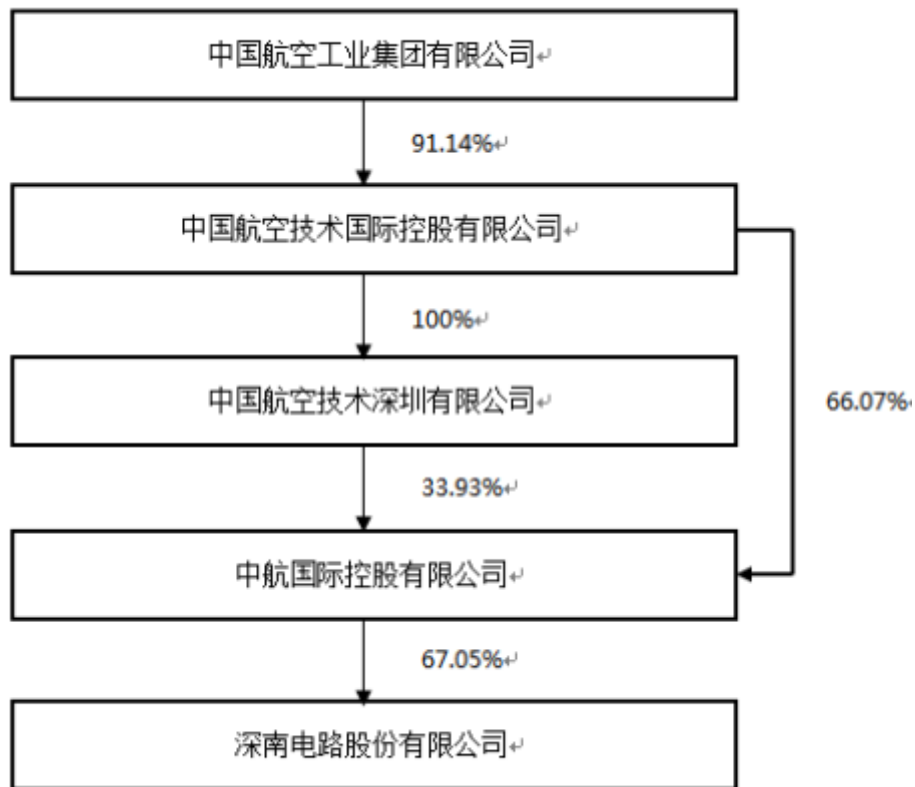
汉基金						
中国农业银行股份有限公司—银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.15%	731,803		0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东李雪红通过普通证券账户持有 203,000 股，通过信用交易担保证券账户持有 1,277,036 股，实际合计持有 1,480,036 股。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

报告期内，公司持续落实“3-In-One”战略，快速应对外部环境变化，紧抓疫情下通信设备、数据中心、存储、医疗设备等市场机会。在宏观经济和下游客户持续承压情况下，PCB业务和封装基板业务实现了逆势增长，电子装联业务略有下降。报告期内，公司实现营业总收入116.00亿元，同比增长10.23%；归属于上市公司股东的净利润14.30亿元，同比增长16.01%。

##### 1、积极抵御风险，保障公司稳定运营

报告期内，严峻复杂的外部环境对公司确保生产运营的稳定、客户风险的有效管理、供应链的安全稳定等工作提出了较大挑战。公司积极搭建业务连续性管理体系（BCM），并快速推动落地，有效保障了公司经营稳定性。

在稳定生产运营方面，公司快速响应，建立抗疫工作小组，制定紧急预案。报告期内，公司始终坚持抗疫、生产双线作战原则，在严格执行国家疫情防控政策下，积极支援医疗、通信、数据中心等客户需求，并获得客户及社会高度肯定。无锡深南电路获得“新冠肺炎疫情防控阻击战优秀青年突击队”荣誉称号。

在市场风险管理方面，公司积极加强应收账款管理，高度关注客户经营连续性与稳定性。在供应链安全稳定方面，公司通过加强供应商开发，实施战略合作，加强原材料库存管理等多种手段积极应对。报告期内，公司实践BCM风险管理流程，对二级供应商发生的风险事件进行排查，形成有效的供应链风险应对策略。

##### 2、三项业务聚焦核心领域，在细分领域持续突破

###### 1) PCB业务：深耕通信市场，数据中心和汽车电子等市场快速成长

报告期内，公司印制电路板业务实现营业务收入83.11亿元，同比增长7.56%，占公司营业总收入的71.64%；毛利率28.42%。受外部环境影响，通信市场需求有所调整，但公司在客户端始终保持稳定的市场份额，市场结构获得进一步优化，在数据中心、汽车电子、医疗电子等市场有较大突破。其中，数据中心订单超过10亿元，占比持续提升。汽车电子市场开发进展顺利，公司与部分国际大客户已建立稳定合作关系，市场订单同比增长84%，并已启动南通三期汽车专业工厂产线建设，建成后将进一步拓展公司在汽车市场的发展空间。

南通数通二期工厂于2020年3月连线试生产，主要面向中高端通信及服务器领域的客户，目前爬坡进展顺利。南通深南实现营收19.03亿元，同比增长53.41%。

###### 2) 封装基板业务：持续加快存储客户开发，加强FC-CSP产品技术研究

报告期内，公司封装基板业务实现营业务收入15.44亿元，同比增长32.67%，占公司营业总收入的13.31%；毛利率28.05%。

2020年，全球半导体行业态势景气度较高，全球封装基板产能相对紧缺。报告期内，公司封装基板业务产能利用率保持较高水平，各项运营指标保持稳定。无锡封装基板工厂产能爬坡有序推进，运营能力持续提升；客户开发达成预期，为业务持续稳定发展提供了充足动力。报告期内，公司封装基板业务主要产品线实现了较大增长。声学类微机电系统封装基板产品（MEMS-MIC，即硅麦克风）技术和产量上继续保持领先优势，订单保持稳定增长；指纹类、射频模块类、eMMC、FC-CSP等封装基板产品订单情况较好。

###### 3) 电子装联业务：加快医疗、汽车等市场开发

报告期内，公司电子装联业务实现营业务收入11.60亿元，同比下降4.21%，占公司营业总收入的10.00%；毛利率14.61%。

电子装联业务属于EMS行业，供应链复杂。受全球新冠肺炎疫情及国际经济环境等因素影响，客户需求及国际贸易节奏均受到一定程度的冲击。报告期内，公司电子装联业务通过加快通信、医疗电子、汽车电子等市场开发，有效抵御市场需求波动风险，其中医疗工控和汽车市场订单同比分别增加33%和28%。无锡产线在园区内顺利完成搬迁，在自动物流及专业产品线建设等方面开始取得了一定成效。

##### 3、持续加强研发投入，保持技术领先优势

报告期内，公司研发投入6.45亿元，同比增长20.15%，占公司营业总收入比例5.56%，主要投向下一代通信印制电路板、存储及FC-CSP封装基板，主要面向高密度、高集成、高速高频、高散热、大容量、小型化等重点领域。

2020年，公司承担的02重大专项“高密度封装倒装芯片基板产品开发与产业化”项目顺利通过验收；公司“高端印制电路板高效高可靠性微细加工技术与应用”项目，荣获国家科学技术进步奖二等奖；此外，深南电路科学技术协会积极推动各项创新工作开展和工程师文化建设，全力支持公司科技工作实现新突破。公司全年主导和参与制定行业标准22件，发布制定的行业标准4件，发表论文29篇，其中国际会议/期刊9篇、国内核心期刊1篇。

2020年公司知识产权布局持续推进，新申请的PCT专利和国际专利取得较大突破。截止报告期末，公司已获授权专利549项，其中发明专利363项；国际PCT专利53项。公司专利授权数量、国际PCT专利通过数量位居行业前列。

##### 4、深入推动数字化变革，提升组织活力与效率

报告期内，公司持续推动智能制造落地，打造基于智能制造生产方式下的运营管理体系。公司有序推进三项业务主要产品线智能化建设和改造工作，完成了包括立体库、自动物流、IMES系统上线等工作，提高了生产运营效率。

南通深南电路“江苏省高速高密度印制电路板及其智能制造工程技术研究中心”通过江苏省科技厅省级工程技术研究中心认定，无锡深南电路通过中国电子技术标准化研究院“智能制造能力成熟度四级”认定；同时，公司统筹上线、更新包括质量系统、供应链系统在内的近20个新数字化管理系统，进一步提升内部运营管理效率。随着自动化、数字化建设的深入，未来公

司还将不断打通精益制造、智能制造与产品能力管理等多个平台，进而对接客户关系管理、供应链管理等系统，实现对客户提供端到端的可管理、可测量、可实现的服务，为客户与股东创造更大价值。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
印制电路板	8,310,580,116.40	2,361,749,565.39	28.42%	7.56%	9.24%	0.44%
电子装联	1,160,037,064.06	169,538,911.47	14.61%	-4.21%	-28.25%	-4.90%
封装基板	1,544,340,753.23	433,193,534.84	28.05%	32.67%	41.77%	1.80%
其他产品	218,746,489.67	56,772,489.81	25.95%	62.54%	78.55%	2.32%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临退市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

详见第十二节、五、37 重要会计政策和会计估计变更。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。